

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

翱捷科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-0905

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称	大成基金、银河基金、嘉实基金 华安基金、工银瑞信、广发基金 兴全基金、交银施罗德、太平基金 华夏基金、平安养老、博时基金 南方基金、海富通、前海开源 光大证券、中信证券、国泰海通 中泰证券、华泰证券、国信证券 (排名不分先后)
时间	2025 年 9 月 1 日至 9 日 5 日
上市公司接待人员姓名	董事长 戴保家 董事、副总经理 赵锡凯 董事、董事会秘书、副总经理 韩旻 投资者关系总监 董跃飞
投资者关系活动主要内容介绍	问：公司芯片定制业务采用何种方式？如何进行收入确认？ 答：公司通常会采用 Turnkey 的模式，为客户提供从设计到量产的一站式服务。包括前道的 Spec In、后道芯片设计

	及最终项目验收后的量产供货。 在收入确认上，芯片设计服务费用的确认，通常由客户最终验收完成后，一次性确认收入，根据项目复杂度的不同，通常需要 1~2 年；量产供货阶段的收入则随当期的销售情况进行确认。 问：关于 Turnkey 一站式芯片定制业务，在量产阶段公司采用何种收费方式？这个阶段的收入是否计入到公司自研芯片产品销售收入中？ 答：通常情况下，公司对已经处于量产供货阶段的定制项目，按成本加成的原则进行收费，这样的收费方式亦符合行业通行模式。该阶段产生的相关芯片销售收入依然计入芯片定制业务板块的收入中，不会归入自研芯片业务板块的收入中。 问：公司目前芯片定制业务在手订单情况如何？具体客户有哪些？对明年相关业务的营收预计如何？ 答：公司的芯片定制业务在手订单充足，但因与客户均签署了保密协议，所以不便于披露具体信息。目前各项目进展顺利，预计明年（2026 年）芯片定制业务的收入较 2024 年将会有倍数级增长。 问：公司和互联网会合作的芯片类型大概有哪些？ 答：主要有可穿戴类芯片及云端推理芯片等。 问：公司在 AP 方面有哪些优势？会不会去布局端侧，比如车、机器人等？ 答：公司为平台性芯片设计公司，拥有丰富的 SoC 项目经验，擅长处理高复杂度的芯片设计工作，且本身自研手机
--	--

	芯片，拥有自研的 VPU/ISP/DPU 等核心模块，在图形、图像和信号处理方面，可实现更高的集成度和功耗控制；在内存与总线架构优化方面，能够设计高效的内存控制器、片上总线，可减少数据延迟，提升多核心数据交互效率；在多媒体与 AI 算力集成方面，拥有自研专用神经网络处理器，可实现 AI 加速器（NPU）深度定制，适配图像识别、语音处理等 AI 任务；在高速接口方面，拥有自研的 DDR、PCIE、USB 等核心接口 IP，适用于各种端侧 AP 应用场景。 基于以上优势，对于端侧客户，包括在车载中控、机器人小脑等相关领域的需求，公司持开放态度，并承接相关定制业务。 问：公司认为 RISC-V 领域，哪个细分市场最先有量？公司是否有相关布局？ 答：公司看好 RISC-V 服务器芯片市场，比如信创、存储等，目前已经和多家企业展开相关合作。 问：公司中报中披露，上半年蜂窝基带产品销售收入较去年同期有较大增长。公司对于下半年的预期如何？ 答：三季度和四季度通常为半导体行业传统旺季。根据目前已出货情况，结合客户提供的 6 个月滚动 forecast 来看，公司持乐观态度，预计全年销售收入再创历史新高的可能性较大。 问：阿里此次减持的主要原因？近期是否还有其他减持计划？ 答：阿里自 2017 年起先后参与公司多轮融资，并长期持有公司股份。此次减持原因主要为其自身商业安排。本次减持完成后，阿里仍然是公司重要股东，且未来持续看好公司
--	---

	及其所处行业的发展前景。截止到目前，公司尚未获知该股东的其他减持计划。后续如有，公司将及时履行信息披露义务。 问：公司 5G 智能手机芯片目前进展如何？研发进度是否符合预期？ 答：目前该芯片已经进入研发后期，即将流片。该芯片具备先进的 5G-A 通信能力及高性能 AI 能力，将进一步完善公司智能手机芯片的产品布局，预计明年下半年开始进行客户导入工作。 问：美国取消台积电南京厂的 VEU 授权豁免，对公司晶圆的产能有什么影响？ 答：公司评估对当前公司获得的产能支持无影响。如未来产能受限，公司会采取到台积电台湾厂流片或与国内供应商合作等方案进行解决。 问：新型 3D DRAM 存储是最近的市场热点，贵公司是否有相关的产品开发计划？ 答：随着大数据、人工智能、高性能计算等领域的快速发展，对高速、大容量、低延迟内存的需求不断增长。我们已经对相关领域进行了先期研发，并已经在定制业务上和 Related 公司进行了深入的项目合作。 同时，本公司也在积极探索在自研端侧产品中除手机之外的扩展应用，包括车载、AI 视觉、机器人小脑等，以提升本公司产品的竞争力。 问：贵司的新签订的设计服务项目，都有哪些客户，涉及哪些工艺？
--	--

	答：公司跟客户签有保密协议，不能披露客户信息。截至目前，今年新增的定制项目均为 6nm 及更先进工艺。 备注：需特别说明的是，本次交流活动问答回复中，所有关于未来业务发展的预期，因预测周期距当前时点尚有一定时间跨度，政策环境、市场情况、项目进度等客观因素可能存在动态变化，具体数据以当年审计数字为准，请投资者注意投资风险。
附件清单 (如有)	无